

Informations de base	
2013/2905(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C Complétant 2008/0240(COD) Subject 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur

Acteurs principaux			
Parlement européen	Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
	<div>ENVI</div> Environnement, santé publique et sécurité alimentaire		

Événements clés			
Date	Événement	Référence	Résumé
18/10/2013	Publication du document de base non-législatif	C(2013)06798	
18/10/2013	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois		
23/10/2013	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
19/12/2013	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Conseil		
07/01/2014	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		

Informations techniques	
Référence de la procédure	2013/2905(DEA)
Type de procédure	DEA - Procédure d'acte délégué
Sous-type de procédure	Examen d'un acte délégué
Modifications et abrogations	Complétant 2008/0240(COD)
État de la procédure	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Dossier de la commission	ENVI/7/14364

--

Commission Européenne

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base non législatif	C(2013)06798	18/10/2013	